

EMC 电磁保护镀铝加工

过程

电镀加工在高真空下进行，纯度 99.98 % 的铝在短时间内蒸发并沉降在塑料表面。镀层厚度约为 2.5 微米。此镀铝层具有特别优良的附着力。其他镀层厚度以增加屏蔽效果可以根据要求定制。

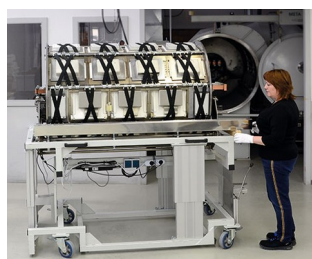
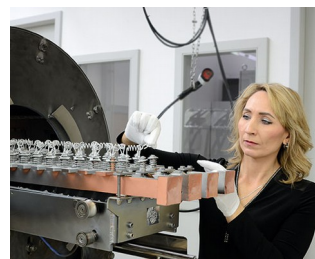
附加资料说明

EMC 屏蔽保护和塑料机盒

塑料机盒常使用非导电材料，如 ABS、PC 和 PA 材料，与金属盒相比，具备抗应力和触摸保护的优点。它的表现像绝缘体。

对于引起电磁干扰或操作时受到这些干扰影响的设备，塑料机盒如无特殊措施只能提供适度的保护。

请注意，当使用外购附件时，保护程度可能会受到影响，并引起腐蚀。因此，我们建议您在使用外购附件前仔细咨询供应商。



保留技术更改可能性。 © OKW 机盒系统, Buchen/德国。